



平成 28 年5月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成 27 年9月 25 日

上場会社名 三益半導体工業株式会社 上場取引所 東
 コード番号 8155 URL <http://www.mimasu.co.jp>
 代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 中澤 正幸
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部長 (氏名) 八高 達郎 (TEL) 027-372-2011
 四半期報告書提出予定日 平成 27 年 10 月 15 日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成 28 年5月期第 1 四半期の業績(平成 27 年6月 1 日～平成 27 年8月 31 日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28 年5月期第 1 四半期	14,343	29.9	1,050	44.2	1,006	30.4	675	34.8
27 年5月期第 1 四半期	11,038	△2.9	728	2.0	772	11.6	500	19.7

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
28 年5月期第 1 四半期	20.17	—
27 年5月期第 1 四半期	14.96	—

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
28 年5月期第 1 四半期	75,151	54,222	72.2
27 年5月期	75,252	53,974	71.7

(参考)自己資本 28 年5月期第 1 四半期 54,222 百万円 27 年5月期 53,974 百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
27 年5月期	—	12.00	—	12.00	24.00
28 年5月期	—	—	—	—	—
28 年5月期(予想)	—	13.00	—	13.00	26.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成 28 年5月期の業績予想(平成 27 年6月 1 日～平成 28 年5月 31 日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	26,500	16.1	1,900	32.8	1,950	11.8	1,200	31.0	35.84
通期	53,000	7.4	3,500	37.0	3,600	20.1	2,200	29.6	65.71

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	28年5月期1Q	35,497,183株	27年5月期	35,497,183株
② 期末自己株式数	28年5月期1Q	2,016,614株	27年5月期	2,016,518株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年5月期1Q	33,480,633株	27年5月期1Q	33,481,132株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】2ページ「(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期財務諸表	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	5
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(セグメント情報)	6

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益が改善するなかで、個人消費が底堅く推移するなど、全体として緩やかな回復基調となりました。

半導体業界におきましては、スマートフォンや自動車向けなどのデバイス需要にけん引され、シリコンウエハーの需要は好調に推移いたしました。

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。

この結果、当第1四半期累計期間の売上高は143億4千3百万円と前年同四半期比29.9%の増収となり、営業利益は10億5千万円(前年同四半期比44.2%増)、経常利益は10億6百万円(同30.4%増)、四半期純利益は6億7千5百万円(同34.8%増)となりました。

半導体事業部

当事業部におきましては、主力の300mmウエハーを中心として、生産は好調に推移いたしました。そうした中で、更なる生産性の向上と原価低減を推進いたしました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。この結果、自社開発製品及びその他の取扱商品ともに増収となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金の減少等により、前事業年度末と比較して1億円減少し、751億5千1百万円となりました。一方、負債合計は未払法人税等の減少等により3億4千8百万円減少し、209億2千9百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加2億7千3百万円等により、542億2千2百万円となりました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成27年8月10日の「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」で公表いたしました第2四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はございません。

2. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成27年5月31日)	当第1四半期会計期間 (平成27年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	25,724	25,001
受取手形及び売掛金	18,893	19,967
商品及び製品	196	161
仕掛品	522	315
原材料及び貯蔵品	1,368	1,583
その他	951	953
貸倒引当金	△3	△3
流動資産合計	47,651	47,978
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	12,156	11,935
その他(純額)	12,076	11,932
有形固定資産合計	24,232	23,868
無形固定資産		
	601	565
投資その他の資産		
その他	2,773	2,746
貸倒引当金	△6	△6
投資その他の資産合計	2,766	2,740
固定資産合計	27,601	27,173
資産合計	75,252	75,151
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	13,723	14,405
短期借入金	100	100
未払法人税等	607	196
引当金	60	416
その他	5,077	4,151
流動負債合計	19,568	19,271
固定負債		
長期借入金	150	125
退職給付引当金	1,374	1,353
その他	185	179
固定負債合計	1,709	1,658
負債合計	21,277	20,929

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成27年5月31日)	当第1四半期会計期間 (平成27年8月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	19,643	19,917
自己株式	△3,410	△3,410
株主資本合計	53,835	54,108
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	139	113
評価・換算差額等合計	139	113
純資産合計	53,974	54,222
負債純資産合計	75,252	75,151

(2) 四半期損益計算書
(第1四半期累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期累計期間 (自平成26年6月1日 至平成26年8月31日)	当第1四半期累計期間 (自平成27年6月1日 至平成27年8月31日)
売上高	11,038	14,343
売上原価	9,725	12,611
売上総利益	1,313	1,732
販売費及び一般管理費	584	681
営業利益	728	1,050
営業外収益		
受取利息	2	2
受取配当金	4	4
為替差益	29	—
その他	6	10
営業外収益合計	43	17
営業外費用		
支払利息	0	0
為替差損	—	59
その他	0	1
営業外費用合計	0	61
経常利益	772	1,006
特別利益		
固定資産売却益	2	0
受取保険金	17	—
特別利益合計	19	0
特別損失		
固定資産除却損	0	5
その他	—	26
特別損失合計	0	32
税引前四半期純利益	790	974
法人税、住民税及び事業税	35	157
法人税等調整額	254	142
法人税等合計	289	299
四半期純利益	500	675

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

報告セグメントごとの売上高に関する情報
前第1四半期累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年8月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	5,371	5,666	—	11,038	—	11,038
セグメント間の内部売上高 又は振替高	0	—	345	346	△346	—
合計	5,372	5,666	345	11,385	△346	11,038

当第1四半期累計期間 (自 平成27年6月1日 至 平成27年8月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	5,997	8,345	—	14,343	—	14,343
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1	—	915	917	△917	—
合計	5,999	8,345	915	15,260	△917	14,343